

神工半导体ThinkonSemi

神工半导体（ThinkonSemi）于2013年7月在中国辽宁省锦州市创立，现在全称为锦州神工半导体股份有限公司。

自公司诞生之日起，神工半导体就秉持“科技创新，技术报国”的宗旨和“专注技术、强调质量、服务客户”的经营理念，专注于集成电路刻蚀用单晶硅材料的研发、生产和销售。凭借高质量的产品和完善的售后服务，神工半导体在集成电路刻蚀用单晶硅材料领域树立了良好的口碑，已成功进入国际先进半导体材料产业链体系，并确立了行业地位。

经过多年的技术研发和积累，在工艺上追求精益求精、不断攀登行业高峰，神工半导体突破并优化了多项关键技术。公司所拥有的无磁场大直径单晶硅制造技术、固液共存界面控制技术、热场尺寸优化工艺等技术均已处于国际先进水平。

目前，神工能够以高成品率量产最大 475mm（19英寸）的超大直径半导体级硅单晶材料，电阻率涵盖70-80 $\cdot \text{cm}$ ，1-4 $\cdot \text{cm}$ 和<0.02 $\cdot \text{cm}$ 等规格，能满足客户对各类高中低阻产品的需求。除了提供硅单晶棒，神工还具有一定的后续晶棒加工能力，能够提供硅筒、硅盘片、硅环片等产品。公司产品几乎全部产品出口到日本、韩国和美国等国的主流客户。

今后，随着半导体集成电路产业链国产化进程的演变，神工半导体将不断创新开拓，在服务好既有国外客户的基础上，逐渐扩大服务到国内的新客户，与客户一起发展壮大，为成为中国乃至世界半导体硅材料领域的领先者而砥砺前行。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/sghdtthi-296574.html>

